

Electroformed Bond Hub Blades

ZHDG SERIES

实现高质量基板切断的电铸硬刀片

易于操作的基板切断用硬刀片种类丰富，
有多种不同的颗粒大小和集中度，
可实现高质量加工

ZHDG系列用于多种基板的切断，其所采用的颗粒大小大于半导体晶圆用硬刀片，且开发了多种不同的集中度，该系列的硬刀片可满足客户的多种需求。

- 由于附有铝质底座，因此和用于基板切割的无底座刀片相比，具有更好的操作性
- 备有多种不同颗粒大小和集中度的产品可供选择
- 选择低集中度刀片，可减少树脂·金属毛边



■ ZHDG系列的定位



加工对象

晶粒LED基板、多种半导体封装组件、其它材料

